



Editore: **SANDIT LIBRI**

Pagine: **122**

Prezzo: **12.90 €**

Pubblicazione: **13/02/2019**

ISBN: **9788869283024**

## REWORK SMD E BGA

### Le tecniche

di *Davide Scullino*

Questo volume introduce la tecnica SMT e le metodiche di montaggio, sostituzione e rework dei componenti elettronici SMD, spiegando quali sono e come si usano le moderne attrezzature richieste in un laboratorio.

Conoscere i componenti e le tecniche di montaggio superficiale è diventato sempre più importante, perché la gran parte dei circuiti elettronici odierni fa uso di elementi SMD e circuiti integrati ad elevata scala di integrazione, che in futuro tenderanno ad essere sempre più miniaturizzati. I circuiti stampati divengono così sempre più compatti e i componenti vicini, minuscoli e con terminali difficilmente accessibili, il che rende la riparazione o la costruzione dei PCB decisamente ardua, tanto che i tradizionali attrezzi da laboratorio, come il comune saldatore e il filo di lega saldante in molti casi divengono inadeguati. Questo volume introduce la tecnica SMT e le metodiche di montaggio, sostituzione e rework dei componenti elettronici SMD, spiegando quali sono e come si usano le moderne attrezzature richieste in un laboratorio che voglia essere al passo con i tempi; attrezzature che non sono necessariamente diverse, ma in qualche caso solo più piccole e adatte alla gestione dei componenti a montaggio superficiale. Ma anche strumenti e apparati dedicati al montaggio e al rework degli SMD, come le stazioni saldanti e dissaldanti a stilo e quelle a getto d'aria calda (Hot-Air Station) nonché le macchine per il rework dei circuiti contenenti componenti in package BGA. Verranno introdotte tecniche dedicate ai componenti LGA e BGA, come il reflow e il reballing, descrivendo le attrezzature e l'utilizzo delle macchine richieste, senza dimenticare qualche suggerimento pratico per operare con componentistica molto complessa senza dover necessariamente acquistare macchine professionali e inevitabilmente costose.